

Title (en)

Method and apparatus for the manufacture of metallic surface layers on substrates.

Title (de)

Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung metallischer Flächenelemente auf Substraten.

Title (fr)

Méthode et appareil pour la fabrication d'éléments métalliques surfaces sur substrats.

Publication

EP 0563992 A2 19931006 (DE)

Application

EP 93105519 A 19930402

Priority

DE 4211235 A 19920403

Abstract (en)

A novel method for manufacturing substrates with defined metallic surface structure is specified, which method can be used advantageously in particular in the manufacture of reflection holograms on banknotes. In this case the metallic surface elements are produced on a master, for example a printing roller, in peelable form and then transferred directly from the master onto the respective substrate. <IMAGE>

Abstract (de)

Es wird ein neues Verfahren zur Herstellung von Substraten mit definierter Metalloberflächenstruktur angegeben, welches sich insbesondere bei der Herstellung von Reflexion-Hologrammen auf Wertpapieren vorteilhaft einsetzen läßt. Hierbei werden die metallischen Flächenelemente auf einem Master, z. B. einer Druckwalze, in ablösbarer Form, erzeugt und danach direkt vom Master auf das jeweilige Substrat übertragen. <IMAGE>

IPC 1-7

B41M 3/14; **B42D 15/10**; **B32B 15/08**

IPC 8 full level

B32B 15/08 (2006.01); **B41M 3/14** (2006.01); **B42D 15/00** (2006.01); **B42D 15/10** (2006.01); **B42D 25/29** (2014.01); **B44C 1/17** (2006.01); **C23C 14/00** (2006.01); **C23C 14/06** (2006.01); **G03H 1/18** (2006.01)

CPC (source: EP US)

B41M 3/14 (2013.01 - EP US); **B42D 25/29** (2014.10 - EP US); **Y10T 156/1039** (2015.01 - EP US)

Cited by

EP3150400A1; US10618339B2; WO2017055634A1; WO0237192A1; US8242006B2; EP1509813B1

Designated contracting state (EPC)

AT BE CH DE DK ES FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE

DOCDB simple family (publication)

EP 0563992 A2 19931006; **EP 0563992 A3 19950118**; **EP 0563992 B1 19980715**; AT E168327 T1 19980815; DE 4211235 A1 19931202; DE 4211235 C2 20030417; DE 59308760 D1 19980820; JP 3049646 B2 20000605; JP H0679987 A 19940322; US 5807456 A 19980915

DOCDB simple family (application)

EP 93105519 A 19930402; AT 93105519 T 19930402; DE 4211235 A 19920403; DE 59308760 T 19930402; JP 7834593 A 19930405; US 76759996 A 19961202